

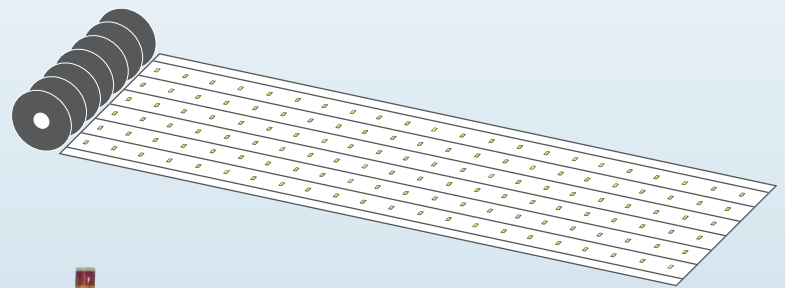
Follow out concept of "safer", "Better", "Faster".

# DRY SLICER

乾式マルチスライサー  
**SAM-CT2MSL**

## 高生産性

長尺LED基板を  
マルチブレードで一括切断



**SAYAKA**

## 特長 Features

### マルチブレードによる切断 Multi-blade cutting

マルチブレードによる一括切断は、生産効率の大幅な向上が計られます。  
Production efficiency is increased by multi blade included in the slicer.

### 長尺基板対応 Capable of cutting long board

Max.1200mmの長尺基板対応で、LED基板などの切断に最適です。  
Max board size is 1200 mm, it is ideal for cutting LED PCB.

### 基板に応じた刃物 Blade corresponding to various PCB.

FR4, CEM3などの基板はGCブレードで、FR1は基板チップソーで切断します。  
Use grinding stone to cut FR4, CEM3, etc., and tip saw to cut FR1.



GCブレード / GC Blade  
(for FR4, CEM3, etc.)



基板チップソー / Tipped Saw  
(for FR1)

### 基板パレット(治具)上で切断 PCB positionig on pallet(JIG)

基板パレットによる位置決めは、切断の精度を上げると共に、基板の自動投入も可能です。  
The cutting accuracy is enhanced and automatic feeding of PCB is possible because PCB is positioned by pallet(JIG).

### 基板の上下から集塵 Collecting dust from top and bottom side

切断中、集塵機により、刃物ケース内と基板パレットの下、両方から切断粉を集塵します。又、集塵機により基板を吸引固定し、安定的に切断できます。  
Dust is collected from the inner side of the blade case and the bottom side of pallet during cutting. And the cutting is stabilized because PCB is adsorbed by dust collector.

### 低ストレス切断・V溝不要 Low stress cutting, V groove free.

切削時にプリント基板に与えるストレス(歪)は極小で、V溝なしでの切断が可能です。

Safe cutting because minimized cutting stress, and need no V-groove for cutting.

## 仕様

対象基板	最大ワークサイズ	L1,200mm × W250mm t=0.8 ~ 2.0mm
	材質	FR4, FR1, CEM3 等
	搭載部品高さ	基板上面 5mm(基板厚み含む)、基板下面 8mm
X軸	モータ種類	パルスモータ
	動力伝達方式	ボールねじ
	切断速度	50 ~ 250mm/sec
	戻り速度	250mm/sec
主軸	モータ出力	1.5KW
	回転数	3,000 ~ 6,000rpm
刃物	GC砥石 (FR4, CEM3 用)	外径 125mm、t0.5mm
	基板チップソー (FR1 用)	外径 125mm、t0.5mm
	切断ピッチ	専用治具により機種対応
基板パレット	基板位置決め	個片内のピン及び基板外形をガイド
	基板固定	集塵機による吸引固定
本体仕様	電源	φ 3 AC200V/200V/220V 50/60/60Hz
	最大消費電力	5KVA(集塵機含む)
	エア供給圧	0.4 ~ 0.5Mpa(無給油)
	エア消費量	約 300 ℓ /min.
	サイズ	W3,190 × D920 × H1,165mm
	重量	約 600kg
集塵機	出力	1.5KW(標準)
	電源・電圧	φ 3 200V 50Hz /60Hz 選択
	サイズ	W650 × D650 × H1,741mm
	重量	約 150kg

## Specifications

PCB	Max.Size	L1,200mm × W250mm t=0.8 ~ 2.0mm
	Material	FR4, FR1, CEM3 etc.
	Component Height Limit	5mm upper surface(incl. PCB thickness), 8mm lower surface
X axis	Type of motor	Pulse Motor
	Transmission system	Ball screw
	Cutting Speed	50 ~ 250mm/sec
	Return Speed	250mm/sec
Main axis	Motor Output	1.5KW
	Rotational Frequency	3,000 ~ 6,000rpm
Blade	GC Wheel(for FR4, CEM3)	OD=125mm、t0.5mm
	Tipped Saw(for FR1)	OD=125mm、t0.5mm
	Cutting Pitch	Changed by dedicated fixture
Pallet(JIG)	PCB positioning	Pin and Outer Shape Guide
	PCB Holding	Adsorbed by dust collector
Equipment	Electricity	φ 3 AC200V/200V/220V 50/60/60Hz
	Max. Power consumption	5KVA(dust collector is count outed)
	Air Pressure	0.4 ~ 0.5Mpa(need no lubrication)
	Air Consumption	Approx.300 ℓ /min.
	Dimension	W3,190 × D920 × H1,165mm
	Net Weight	Approx. 600kg
Dust Collector	Output	1.5KW (STD)
	PowerVoltage	φ 3 200V Select 50Hz or 60Hz
	Dimension	W650 × D650 × H1,741mm
	Net Weight	Approx.150kg

**SAYAKA**  
信頼のパートナー

株式会社サヤカ

〒143-0002  
東京都大田区城南島2丁目3番地3号  
TEL:03(3790)8911  
FAX:03(3790)8917  
URL:<http://www.sayaka.co.jp>

代理店